

HRG200X

High Rigid Grinder

- 全自動高剛性2軸研削盤
- 短時間でダメージがない加工を実現
- 低加工コスト
- 高精度加工
- 鏡面加工を実現します



株式会社東京精密

HRG200X

High Rigid Grinder



対象材料

SiC LT LN 等の難削材

対象ワーク

サイズ：φ3～φ8インチ

加工事例

材料	サイズ	取代	加工時間
SiC	6インチ	100μm	2分
LT	4インチ	100μm	1分
LN	4インチ	100μm	1分

仕様



項番	項目	HRG200X
		全自動高剛性2軸研削盤
1	外観	サイズ：1540(W)X2050(D)X2010(H)mm 重さ：4500kg
2	最大加工径 (mm)	200
3	砥石径 (mm)	250
4	砥石軸回転数 (rpm)	3600
5	ワーク軸回転数 (rpm)	800
6	砥石軸モータ (kw)	6.3
7	ウェ八面内厚みばらつき: TTV(μm)	1
8	ウェ八面厚みばらつき: WTW(μm)	± 1

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所 (042) 631-5211 (042) 631-5234
 大阪営業所 (06) 6821-0361 (06) 6821-0210
 九州営業所 (097) 538-1985 (097) 538-1989

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所 (022) 224-0177 (022) 224-7083
 山形出張所 (023) 631-5125 (023) 625-4129
 鶴岡出張所 (0235) 29-8020 (0235) 29-8022
 東京CE課 (042) 642-0358 (042) 642-0367
 東京CE課/土浦出張所 (0298) 34-8550 (0298) 31-6808
 四日市出張所 (0593) 61-6610 (0593) 66-2210
 北陸出張所 (076) 422-6756 (076) 422-6757

大阪CE課 (06) 6821-0225 (06) 6821-0210
 東広島出張所 (082) 493-5618 (082) 493-5619
 熊本出張所 (096) 387-5188 (096) 386-1592
 九州CE課 (097) 534-3291 (097) 538-1989
 国分出張所 (0995) 43-2510 (0995) 43-2586
 八王子パーツセンター (042) 642-0381 (042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ (029) 830-1882 (029) 830-1881
 土浦事業所パーツセンター (029) 830-1882 (029) 830-1881
 名古屋事業所 (0561) 32-3605 (0561) 34-2744